

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 关于申请增加 2024 年度银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于申请增加 2024 年度银行授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

为满足公司及全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）、深圳伟测半导体科技有限公司（以下简称“深圳伟测”）及天津伟测半导体科技有限公司（以下简称“天津伟测”）的日常生产经营等相关资金需求，便于公司各项业务正常开展，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元银行授信额度。本次增加人民币 2.5 亿元银行综合授信额度后，公司及子公司 2024 年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 14.40 亿元。具体增加授信明细如下：

单位：万元

序号	授信方	授信金额	授信期限	额度使用单位
1	兴业银行股份有限公司	10,000	1 年	公司及无锡伟测、南京伟测、深圳伟测、天津伟测
2	中国建设银行股份有限公司 上海张江分行	10,000	2 年	公司
3	交通银行股份有限公司无锡 区支行	5,000	1-3 年	无锡伟测
<b>合计</b>		<b>25,000</b>	—	—

上述授信业务类型包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、

票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务。具体授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

签订上述授信额度相关协议的有效期为自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，董事会授权公司董事长骈文胜先生或其授权代表在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日